



## 特色

- ▶ 标准 JEDEC 封装外形
- ▶ 多晶粒制造能力
- ▶ 一站式测试服务、包括条带测试选项
- ▶ 标准绿色材料 – 无铅且符合 RoHS 要求

# PDIP

PDIP (塑料双列直插式封装) 经过实践考验, 是组装各种应用的逻辑、存储器、微控制器及其他设备的常见选项。

## 工艺亮点

- ▶ 支持晶圆背面研磨
- ▶ 多晶粒和晶粒堆叠能力
- ▶ 标准为 PPF 引脚精加工, 雾面锡引脚可选
- ▶ 在封装上使用激光打标
- ▶ 可提供标准的镀金 PCC 线材、金线和银线

## 可靠性认证

Amkor 封装合格审定使用三个独立的生产批, 每个测试组有至少 77 个器件。所有测试均包括 JSTD-020 湿度预处理。

- ▶ uHAST : 130°C/85% 相对湿度、无偏置、96 小时
- ▶ 温度循环 : -65°C/+150°C、500 次循环
- ▶ 高温储存 : 150°C、1000 个小时

## 服务与支持

Amkor 提供丰富的资源, 帮助客户以尽可能低的成本将优质的产品迅速推向市场。

- ▶ 全封装特性
- ▶ 热、机械应力和电性能建模
- ▶ 一站式组装、测试和直接发货
- ▶ 世界级可靠性测试和故障分析

# PDIP

## 测试服务

- ▶ 程序生成/转换
- ▶ 晶圆探针测试
- ▶ 耐老化性能
- ▶ 可提供 -55°C 至 +165°C 测试
- ▶ 可提供条带测试

## 装运

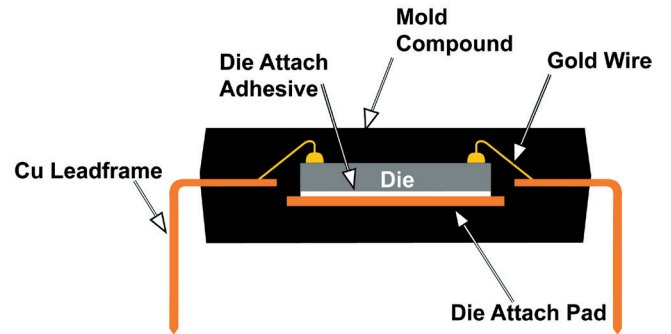
- ▶ 透明防静电管，20 英寸
- ▶ 直接代发货

## 配置选项

PDIP 标称封装尺寸 (mil)

引脚数量	引脚肩宽	封装肩宽	封装长度	封装厚度	间隔	引脚节距	JEDEC
8	300	252	365	130	15	100	MS-001
14	300	252	750	130	15	100	MS-001
16	300	252	750	130	15	100	MS-001

## PDIP 的横截面



访问 [amkor.com](http://amkor.com) 或发送电子邮件至 [sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com) 以获得更多信息。



关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2019 Amkor Technology Incorporated. 保留所有权利。DS397K 修改日期：05/19

